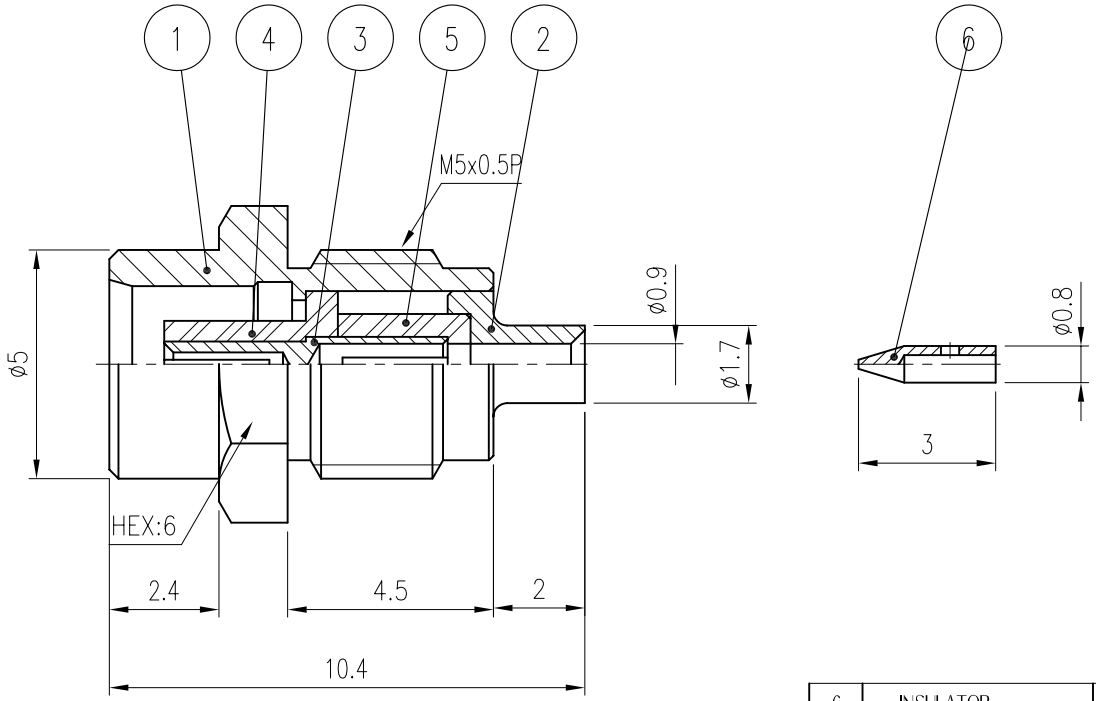
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00023-N/1 (H1056)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00052-N/1 (H1055)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00100-135/1 (E2007)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00034-1345/1 (E1055)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01313-135/1 (D1077)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00085-135/1 (D1076)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 1999. 8. 10.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 MCX-BJ-034

A4

도번 CN00031-7/1

K313-302-000